

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**常州银河世纪微电子股份有限公司**

**首次公开发行股票并在科创板上市**

**之**

**上市保荐书**

保荐机构



**中信建投证券股份有限公司**  
**CHINA SECURITIES CO.,LTD.**

二〇二〇年五月

## 保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人梁宝升、王家海根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

释 义 .....	3
<b>第一节 本次证券发行基本情况 .....</b>	<b>5</b>
一、发行人基本情况 .....	5
二、发行人本次发行情况 .....	18
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 .....	19
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 .....	20
一、保荐机构内部审核程序和内核意见 .....	21
二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺 .....	22
<b>第三节 对本次发行的推荐意见 .....</b>	<b>24</b>
一、发行人就本次发行上市履行了必要的决策程序 .....	24
二、发行人符合科创板定位 .....	24
三、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》规定的科创属性指标 .....	25
四、发行人符合上市条件 .....	26
五、对发行人持续督导工作的安排 .....	29
六、保荐机构结论性意见 .....	31

## 释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通名词释义		
保荐机构、本保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
银河微电、公司、发行人	指	常州银河世纪微电子股份有限公司
银河星源	指	常州银河星源投资有限公司，本公司控股股东
恒星国际	指	恒星国际有限公司（Action Star International Limited），本公司股东
银江投资	指	常州银江投资管理中心（有限合伙），本公司股东
银冠投资	指	常州银冠投资管理中心（有限合伙），本公司股东
聚源聚芯	指	上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），本公司股东
股票、A 股	指	公司本次发行的人民币普通股股票
本次公开发行、本次发行	指	公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
《公司章程》	指	《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《评价指引》	指	《科创属性评价指引（试行）》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
报告期各期	指	2017 年度、2018 年度和 2019 年度
报告期各期末	指	2017 年末、2018 年末和 2019 年末
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语释义		
半导体分立器件	指	以半导体材料为基础的，具有固定单一特性和功能的电子器件，如：二极管、三极管等。
集成电路	指	将一定数目的三极管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一个芯片里，从而实现电路或者系统功能的电子器件。
小信号器件	指	耗散功率不超过 1W（或者额定电流不超过 1A）的分立器件
功率器件	指	耗散功率超过 1W（或者额定电流超过 1A）的分立器件
光电器件	指	利用半导体光-电子（或电-光子）转换效应制成的各种功能器件。

二极管	指	是一种具有正向导通、反向截止功能特性的半导体分立器件。
三极管	指	全称为半导体三极管，包括双极晶体管、场效应晶体管等。
MOSFET	指	MOS管,是金属(metal)-氧化物(oxide)-半导体(semiconductor)场效应晶体管,属于电压控制型器件。
芯片	指	如无特殊说明,本文所述芯片专指半导体分立器件芯片,系通过在硅晶圆片上进行抛光、氧化、扩散、光刻等一系列的工艺加工后,在一个硅晶圆片上同时制成许多构造相同、功能相同的单元,再经过划片分离后便得到单独的晶粒,即为芯片。这个芯片虽已具有了半导体器件的全部功能,但还需要通过封装后才能使用。
晶圆	指	是制造半导体芯片的硅单晶片,由于其形状为圆形,故称为晶圆。
整流	指	用二极管将周期变化的交流电变成单向脉动直流电的过程。
封装测试、封测	指	封装是把芯片按一定工艺方式加工成具有一定外形和功能的器件的过程。测试是把封装完的器件按一定的电性规格要求进行区分,把符合规格与不符合规格的产品分开的过程。

注:本上市保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原因所致。

## 第一节 本次证券发行基本情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人简介

中文名称:	常州银河世纪微电子股份有限公司
英文名称:	Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co., Ltd.
注册资本:	9,630.00 万元
法定代表人:	杨森茂
成立日期:	2006 年 10 月 8 日
整体变更为股份有限公司日期:	2016 年 11 月 18 日
住所:	常州市新北区长江北路 19 号
邮政编码:	213022
电话:	0519-68859335
传真:	0519-85120202
互联网网址:	<a href="http://www.gmesemi.com">http://www.gmesemi.com</a>
电子信箱:	<a href="mailto:info@gmesemi.com">info@gmesemi.com</a>
董事会秘书:	金银龙

#### (二) 发行人主营业务

公司是一家专注于半导体分立器件研发、生产和销售的高新技术企业。以封装测试专业技术为基础，公司不断推进研发创新，已经具备多门类系列化器件设计、部分品种芯片制造、多工艺封装测试以及销售和服务的一体化经营能力。公司掌握了 20 多个门类、近 80 种封装外形产品的设计技术和制造工艺，已量产 8,000 多个规格型号的分立器件，是细分行业中产品种类最为齐全的公司之一，可以提供适用性强、可靠性高的系列产品及技术解决方案，满足客户一站式采购需求。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、适配器及电源、网络通信、汽车电子、工业控制等领域。

公司注重技术研发与创新，公司及子公司银河电器均为高新技术企业。在专利成果方面，公司目前拥有有效专利 182 项，其中发明专利 23 项。在资质认证方面，公司技术中心是“江苏省认定企业技术中心”，建有“江苏省半导体分立器件芯片与封装工程技术研究中心”、“江苏省片式半导体分立器件工程技术研究

中心”。在产品创新方面，公司目前拥有江苏省认定的高新技术产品 18 项，常州市认定的高新技术产品 21 项，快恢复二极管、肖特基二极管、MOSFET 等多项产品列入《战略性新兴产业分类（2018）》重点产品目录。

公司 2017-2019 年被中国半导体行业协会评为“中国半导体功率器件十强企业”、2019 年被中国半导体行业协会封装分会评为“中国分立器件封装产能十强企业”。此外，公司成功加入国际汽车电子协会，在半导体器件领域与英飞凌、安森美等公司同为该协会技术委员会（AEC Technical Committee）成员。

### （三）发行人核心技术

工艺环节	核心技术	技术特点和优势	对应发明专利	技术来源	先进程度
封装测试	高密度阵列式框架设计技术	效率高，成本低。	（1）超薄封装元件的制作工艺；（2）大电流/高压二极管的制备方法； （3）一种半导体芯片的焊接方法；（4）芯片背面涂覆锡膏的装片方法； （5）一种半导体整流桥的制备方法；（6）轴向二极管及保护胶层为聚酰亚胺胶的轴向二极管的制备方法；（7）用于六角芯片的筛选工装及筛选方法；（8）一种用于半导体台面钝化的复合保护涂料及其制备方法；（9）LED 白光二极管的制备方法。	自主研发	国内先进
	芯片预焊技术	焊接空洞小，焊层均匀，焊区面积与芯片面积接近，可靠性好，效率高。			
	绝缘膜装片技术	适合多芯片绝缘隔离叠装，提升产品集成度。			
	超低弧度焊线技术	满足薄型封装的要求。			
	点胶量 CPK 自动测量控制技术	胶量受控，一致性好。			
	功率芯片画锡焊接技术	芯片平整度好，焊锡空洞少。			
	光耦 CTR 控制技术	CTR 一次对档率高。			
	低应力焊接封装技术	提升客户应用的抗应力能力。			
	高温反向漏电控制技术	降低高温下的反向漏电流，提高产品稳定性。			
	跳线焊接技术	散热好，耐冲击能力强。			
成型技术	MGP 模封装技术	产品气密性好，材料消耗少。	（1）芯片级封装方法； （2）一种去除二极管或三极管的引线及框架上的溢料的方法；（3）半	自主研发	国内先进
	变速注塑技术	避免焊线冲弯，提升产品良率。			

		光电产品复合封装技术	提高光电产品的透光率，保证绝缘耐压满足安规要求。	导体构件封装工艺过程用周转工装；（4）光电耦合器的封装方法；（5）LED 发光二极管的集约封装方法。		
	测试技术	基于产品特性数据分析的测试技术	有效筛选掉风险较高的单品和批次，降低失效率。	（1）编带二极管刷检装置；（2）二极管反向电压测试自动定向装置。 （3）一种快速估算器件高温工作时结温的方法。	自主研发	国内先进
		基于 FMEA 的测试技术	有效剔除存在潜在失效风险的产品，及时发现产线品质波动，降低市场失效风险。			
		全参数模拟寿命试验验证技术	确保全生命周期的品质稳定；保障产品性能更大程度满足客户要求；为设计开发提供技术支撑；助力进入汽车电子等高可靠性要求行业。			
芯片制造	平面芯片制造技术	平面结构芯片无环高耐压终端技术	产品精度高，整流二极管反向击穿电压精度可达 5%；品质稳定，参数一致性好，可靠性高。	（1）一种半导体芯片的制备方法；（2）硅片的清洗工艺；（3）六角形硅片的制造方法；（4）半导体晶粒芯片的自动筛分装置。	自主研发	国内领先
		平面结构芯片表面多层钝化技术				
		平面结构功率稳压二极管、TVS 芯片设计及制备技术	产品精度高，反向击穿电压精度达 2%；常温及高温漏电流小；钳位电压低；动态阻抗小。品质稳定，可靠性高。			
	台面芯片制造技术	台面结构特种工艺功率 FRD 芯片设计及制备技术	良好稳定的正反向动态特性；开关时间一致性好。高温性能优，可靠性高。GPP 芯片钝化保护技术提升了芯片的热稳定性、可靠性。		自主研发	国内先进

#### （四）发行人研发水平

##### 1、封测能力：公司在封装规格数量、封装尺寸及功率密度、封装良率及失效率方面达到国内领先企业同等水平

封测对器件特定电性参数及器件稳定性有较大影响，与芯片结合实现器件功能。企业封测能力主要体现在所掌握的封装规格数量、能够达到的极限封装尺寸和功率密度、稳定性和失效率等方面。封装规格越多、尺寸及参数覆盖范围越广，公司进行产品一体化设计并满足客户需求能力越强，同时由于分立器件具备批量使用的属性，大批量生产下的失效率也是市场和客户考虑的重要方面。

在封装规格方面，公司具有行业内主流的引线键合、框架焊接、轴向焊接以



及玻璃烧结四大封装工艺平台，能够提供多样化的封装外形供客户选择。公司不断开发新的封装外形及新的型号规格，目前掌握了 20 多个门类、近 80 种封装外形产品的设计技术和制造工艺，已量产 8,000 多个规格型号分立器件，是细分行业中产品种类最为齐全的公司之一，掌握的封装规格型号与国内领先企业处于同一水平，小信号器件、功率二极管类优势产品的型号较其他公司更为齐全。具体情况如下：

产品类别	主要规格型号	发行人	扬杰科技	苏州固锴	
小信号器件	二极管	小信号开关二极管	16 种，135 款， 25~300V	9 种，36 款， 75~250V	6 种，31 款， 25~200V
		小信号肖特基二极管	13 种，286 款， 7~100V	8 种，54 款， 20~70V	7 种，62 款， 10~100V
		稳压二极管	9 种，1,742 款， 7~100V	7 种，375 款， 1.8~91V	5 种，848 款， 2.2~200V
		ESD 保护二极管	14 种，158 款	3 种，10 款	无半导体类器件， 只有 7 款聚合物产品
	三极管	小信号三极管	9 种，219 款， 12~480V	4 种，79 款， 25~400V	-
		数字三极管	5 种，109 款	4 种，11 款	-
		小信号 MOSFET	9 种，101 款， 12~600V	6 种，43 款， 15~100V	-
功率器件	二极管	整流二极管	17 种，312 款， 50~5000V	9 种，174 款， 50~1300V	16 种，369 款， 50~2,000V
		快恢复二极管	19 种，1,150 款， 50~5000V	16 种，514 款， 50~1200V	20 种，888 款， 50~2,000V
		肖特基二极管	21 种，841 款， 20~300V	20 种，380 款， 20~300V	21 种，628 款， 20~300V
		稳压二极管	11 种，1,061 款， 1~390V	4 种，219 款， 3~390V	4 种，476 款， 2.35~200V
		TVS	8 种，1,665 款， 5~550V	7 种，2216 款， 5~600V	9 种，1,232 款， 5~550V
	三极管	MOSFET	8 种，73 款， 25~900V	10 种，72 款， 16~100V	-
		双极型三极管	9 种，219 款， 12~480V	-	-
	整流桥	贴片桥	10 种，77 款， 20~1,000V	8 种，80 款， 50~1,000V	8 种，128 款， 20~1400V
		插件桥	7 种，66 款， 400~1,000V	30 种，399 款， 50~1,600V	19 种，477 款， 50~1,000V

注：数据来源于各公司官方网站，产品分类按与公司可比的维度进行整理汇总

在封装尺寸和功率密度方面，分立器件的封装始终沿着更小的尺寸和更高的功率密度方向发展，虽然由于终端器件使用场景的多样性各代封装之间不存在完全替代的关系，但能做到的极限封装尺寸越小、功率密度越高，则企业在进行产品设计时可采用的工艺路径空间越大，可以更大程度满足客户需求。在小型化方面，公司目前批量生产的 DFN 封装最小尺寸可以达到  $0.6 \times 0.3 \times 0.3$ （毫米），更小尺寸的第五代芯片级封装也已进入试样阶段，在功率密度方面，公司采用 Clip 和画锡工艺的 PDFN $3 \times 3$ 、PDFN $5 \times 6$  等新型高功率密度封装技术已经逐步成熟，达到国内同行业先进水平。

公司持续研发封装专业技术和批量生产控制技术，不断降低产品失效率。公司研发的矩阵式高密度框架、多芯片组合、多种类引线键合、Clip 组装一体化、MGP 和 AUTO 模、多层复合封装、PAT 测试等封装专业工艺和控制技术被广泛应用于批量生产，市场失效率控制在同行业先进水平，具体如下：

公司	失效率指标	失效率水平
扬杰科技	大功率器件失效率	百万分之几
光莆股份	LED 封装器件失效率	低于百万分之 5
银河微电	分立器件平均失效率	低于百万分之 5

数据来源：根据公告过分立器件类产品市场端失效率相关公司公告内容整理

由此，公司在封装规格数量、封装尺寸及功率密度、封装良率及失效率方面达到国内领先企业同等水平。

## 2、芯片能力：公司通过研发具备较强的芯片设计和部分芯片制造能力，自主研发的部分品种平面高压芯片性能国内领先

公司积极投建芯片研发、制造平台，具备业内主流的台面芯片线成熟产能，同时通过自身研发具备了国内先进的平面芯片产线及工艺平台。依托上述产线和工艺平台，公司掌握了大量芯片的特性数据以及生产工艺，具备较强的芯片设计、性能识别、检测认证，以及芯片与封装结合研发的能力，可以根据设计要求自主制定芯片完整的技术标准和生产工艺，进而选择合适的芯片来源或者在自有芯片线流片。通过该种模式能够满足公司对 1,000 余种芯片的需求，形成了公司齐全的产品类别和竞争优势。

台面工艺是传统的分立器件芯片生产路线,通过采用深结扩散和基区结构控制,能实现不同芯片功能,具有工艺成熟、操作方便的特点,易于批量生产,公司是国内较早掌握台面工艺芯片设计、生产能力的公司之一。同时,为形成自身差异化竞争优势,公司将制造三极管的平面工艺与制造二极管的表面金属化工艺有机结合形成独特的平面二极管芯片工艺并投建产线,于2016年实现量产。公司具备自制能力的芯片种类如下:

芯片结构	芯片种类
台面芯片	整流二极管芯片
	高反压整流二极管芯片
	高浪涌能力车用整流二极管芯片
	超快恢复开关二极管芯片
	硅双向触发二极管芯片
平面芯片	桥堆用整流二极管芯片
	高压整流二极管芯片
	超低压降整流二极管芯片
	瞬态电压抑制二极管芯片
	高压触发二极管芯片
	固态放电管芯片
	阻尼二极管芯片
	汽车用雪崩二极管芯片

公司已量产的平面结构高压整流、超低压降整流芯片实现了耐压达1,000V以上,且具有参数稳定、一致性好、高温特性好、可靠性高的优势,在测试中性能表现与威世科技同类产品结果趋同;平面结构瞬态电压抑制及其他保护芯片参数范围广、一致性好、电压精度高、高温特性好、钳位电压低,在测试中性能表现与国际领先专业保护器件商力特同类产品结果趋同。

公司依托自身的芯片研发、制造平台具备了较强的芯片设计能力及部分品种芯片自主产能,在高压整流、稳压等具有市场前景的功率器件芯片领域成功开发出性能指标处于国内领先水平的平面高压芯片。

### 3、基于封装测试和芯片制造核心技术,公司具备较强的器件设计能力

依托于封测和芯片核心技术的支撑以及长期积累的产品研发数据,公司将芯片设计及制造技术、丰富的封装专业工艺技术组合进行产品设计的能力。

公司具备根据线路应用环境(电流、电压、频率、波形、温度、干扰等)和

安装要求确定产品设计指标的能力，并具备对器件的电、热、环境、力等进行全方位测试验证及芯片设计仿真能力，可以对器件样品进行精确的拆解分析进而形成设计要求。

公司掌握系列二极管、三极管、ESD 系列器件、TVS 及其他保护类器件、功率 SKY 和 MOSFET、整流桥、光电耦合器、车用 LED 灯珠等产品的设计能力，产品涵盖 20 多个门类、8,000 多个规格型号，性能和可靠性等技术规范全部依据国际同行业标准，具备实施进口产品替代和出口参与国际市场竞争的能力。

### （五）发行人主要财务数据及财务指标

项目	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度
资产总额（万元）	69,943.93	65,555.12	66,911.98
归属于母公司股东权益合计（万元）	50,595.62	47,319.41	41,660.14
资产负债率（母公司）	24.30%	23.81%	33.96%
资产负债率（合并）	27.66%	27.82%	37.74%
营业收入（万元）	52,789.38	58,538.27	61,170.46
净利润（万元）	5,272.45	5,588.01	5,461.24
归属于母公司股东的净利润（扣非后）（万元）	4,961.14	5,315.85	5,284.49
基本每股收益（元）	0.56	0.58	0.57
稀释每股收益（元）	0.56	0.58	0.57
加权平均净资产收益率	11.02%	12.56%	13.65%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	10,637.68	6,414.65	6,936.01
现金分红（万元）	2,357.50	-	2,891.70
研发投入占营业收入的比例	6.10%	5.90%	5.72%

### （六）发行人的主要风险提示

#### 1、技术风险

##### （1）新产品开发风险

半导体产业的下游是各类电子电器产品，随着终端产品在例如轻薄化、高功率密度等方面要求的不断提高，以及汽车电子、工业控制等新的应用场景不断涌现，客户对公司不断优化现有产品性能并根据其提出的要求进行新产品开发的能

力要求较高。

在产品优化及开发过程中，公司需要根据客户要求对器件整体设计，包括芯片的性能指标、结构，所采用的封装规格，芯片与封装的结合工艺以及成品检测方法等，对公司技术能力要求较高，同时还需保证产品具有较好的成本效益。如公司无法持续满足客户对新产品开发的要求，将造成公司业绩增长放缓，对盈利能力造成负面影响。

#### （2）技术研发不及预期风险

公司依靠核心技术开展生产经营，只有不断推进新的芯片结构和生产工艺、封装规格、测试技术等方面的储备技术的研发，才能为公司在进行产品设计时提供更大的技术空间和多工艺平台的可能性，以便更好的满足客户需求。

发行人主要依靠自主研发形成核心技术，但由于分立器件是多种学科技术的复合产品，技术复杂程度高，新技术从研发至产业化的过程具有费用投入大、研发周期长、结果不确定性高等特点。另外，由于基础技术的研发课题、研发方向具备一定的前瞻性、先导性，研发成果存在着一定的市场化效果不及预期，或被国外已有技术替代的风险。因此，如果公司的研发活动未取得预期结果，或者研发结果产业化进程不及预期，将使公司大额研发投入无法实现成果转化，影响公司经营业绩。

#### （3）核心技术人员流失及技术泄密风险

半导体分立器件行业是技术密集型行业，公司的产品性能、创新能力、新产品开发均依赖于稳定的技术团队以及自主创新能力，如果公司核心技术人员流失或发生核心技术泄密的情况，就很有可能会削弱公司的市场竞争能力，影响公司在行业内的竞争地位。

#### （4）与国际领先企业存在技术差距的风险

经过 60 余年的发展，以英飞凌、安森美、意法半导体为代表的国际领先企业占据了全球半导体分立器件的主要市场份额，市场集中度较高。同时，国际领先企业掌握着多规格中高端芯片制造技术和先进的封装技术，其研发投入强度也高于国内企业，在全球竞争中保持优势地位。

由于国际大型半导体公司对行业新技术实行严格的封锁政策，国内半导体公司很难通过与国外公司技术合作的方式开发新产品。虽然国内半导体分立器件企业近年来通过持续不断的引进、消化、吸收和再创新，在部分领域实现进口替代，但整体而言与国际领先企业的技术水平还存在一定差距，公司在新产品研发和市场竞争中存在由于技术差距而处于不利地位的风险。

## 2、经营风险

### （1）宏观经济波动风险

半导体分立器件行业是电子器件行业的子行业，电子器件行业渗透于国民经济的各个领域，行业整体波动与宏观经济形势具有较强的关联性。公司产品广泛应用于计算机及周边设备、家用电器、网络通信、汽车电子等下游领域，如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，上述行业的整体盈利能力会受到不同程度的影响，半导体分立器件行业的景气度也将随之受到影响。下游行业的波动和低迷会导致客户对成本和库存更加谨慎，发行人产品的销售价格和销售数量均会受到不利影响，进而影响公司盈利水平。

### （2）经营业绩下滑的风险

报告期内，由于受到全球半导体行业景气程度、国内宏观经济状况、外部贸易环境等因素的多重影响，公司各年分别实现营业收入 61,170.46 万元、58,538.27 万元、52,789.38 万元，呈现逐年下降的趋势。若公司不能加强产品研发和市场拓展，收入规模无法在市场景气度提升时恢复增长，公司将面临经营业绩持续下滑的风险。

### （3）国际经贸摩擦风险

经贸关系随着国家之间政治关系的发展和国际局势的变化而不断变化，在经济全球化日益深化的背景之下，经贸关系的变化对于我国的宏观经济发展以及特定行业景气度可以产生深远影响。报告期内，随着 2018 年开始的中美贸易摩擦逐渐加剧，对诸多电子行业终端客户的经营情况产生影响，上述客户在外部环境紧张的情况下减少了采购和生产量，造成公司营业收入小幅下滑。

虽然近期中美贸易关系已有所缓和，但在全球主要经济体增速放缓的背景

下,贸易保护主义及国际经贸摩擦的风险仍然存在,如未来发生大规模经贸摩擦,仍存在对公司业绩造成不利影响的风险。

#### (4) 产业政策变化的风险

在产业政策和国民经济发展的推动下,我国半导体分立器件行业整体的技术水平、生产工艺、自主创新能力和技术成果转化率有了较大的提升。若国家降低对相关产业扶持力度,将不利于国内半导体分立器件行业的技术进步,加剧国内市场对进口半导体分立器件的依赖,进而对发行人的持续盈利能力及成长性产生不利影响。

#### (5) 行业利润率水平下滑的风险

半导体分立器件毛利率水平随着产品技术成熟而降低,具有周期性特点。目前半导体分立器件行业低端产品竞争激烈,利润空间被挤压;而中高端产品受到技术壁垒、资金投入、行业与客户认证等因素影响,进入者相对较少,利润率水平能在较长的一段时期内保持稳定,甚至随着新兴市场需求的的增长而有所上升。

公司目前在计算机及周边设备、家用电器、汽车电子、工业控制等中高端领域毛利率相对较高,但随着产业的进一步发展、新进竞争者的加入,上述领域的利润空间也存在被压缩的可能性,如果公司未来不能持续跟随市场需求的发展进行产品结构调整和升级,可能面临利润水平下降的风险。

#### (6) 市场竞争风险

受益于计算机及周边设备、家用电器、网络通信等下游市场需求的拉动,以及以物联网、轨道交通、节能环保、新能源汽车等为代表的战略性新兴应用市场的快速发展,我国目前已成为全球最大的半导体分立器件市场,并保持着较快的发展速度,这可能会吸引更多的竞争对手加入从而导致市场竞争加剧。如果在产品技术升级、营销网络建设、智能制造等方面不能适应市场变化,公司面临的市场竞争风险将会加大,存在一定的销售规模和盈利能力下降的风险。

#### (7) 外销增长持续性风险

报告期各期,公司外销收入占比均超过 25%,海外市场是公司重要的收入来源,并促进公司产品结构、客户结构持续提升。影响外销收入规模的因素较为复

杂：其一，外销涉及报关、海运等流程，交货期和回款期较长，存在一定的不确定性；其二，外销受客户所在国家或地区地缘政治、贸易政策、采购政策影响较大；其三，报告期内公司主要外销客户集中在台湾、日韩地区，上述地区半导体产业实力雄厚、工艺精良，公司产品面临一定的竞争和替代风险。因此，如因出口地的经济状况、贸易政策、市场竞争等因素造成公司出口规模下降，将对公司经营业绩产生不利影响。

#### （8）原材料价格波动风险

报告期内，公司材料成本占成本的比例超过 60%，对公司毛利率的影响较大。公司所需的主要原材料价格与硅、铜、石油等大宗商品价格关系密切，受到市场供求关系、国家宏观调控、国际地缘政治等诸多因素的影响。如果上述原材料价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。

### 3、管理风险

#### （1）产品质量管理风险

报告期内，公司质量控制制度和措施实施情况良好，但随着公司经营规模的持续扩大，客户对产品质量的要求提高，如果公司不能持续有效地完善相关质量控制制度和措施，公司产品质量未达客户要求，将影响公司的市场地位和品牌声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。

#### （2）实际控制权过于集中的风险

本次股票发行前，杨森茂持有银河星源、恒星国际 95% 股权，并担任银江投资、银冠投资普通合伙人和执行事务合伙人，通过上述主体累计控制公司股权比例达到 92.33%，为公司实际控制人且处于绝对控股地位。实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权和日常经营管理权对公司的重大人事、经营决策等产生影响，从而在一定程度上影响本公司的重大经营管理决策。

### 4、财务风险

#### （1）存货减值风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,718.09 万元、7,278.22 万元和



7,953.17 万元，占公司总资产比例分别为 11.53%、11.10%和 11.37%。

报告期内，针对存货中在产品 and 产成品余额较高的状况，公司通过完善存货管理制度促使存货在资产总额中所占比例基本保持合理水平，但如果市场形势发生重大变化，公司未能及时加强生产计划管理和库存管理，可能出现存货减值风险。

## （2）税收优惠政策变动的风险

公司享受的税收优惠主要包括高新技术企业所得税率优惠、部分项目加计扣除等。公司及子公司银河电器均系高新技术企业，发行人分别于 2016 年 11 月、2019 年 12 月通过审批被认定为高新技术企业，子公司银河电器于 2017 年 11 月通过审批被认定为高新技术企业，因此报告期内发行人、银河电器减按 15% 的税率征收企业所得税。如果未来未取得高新技术企业资质，或者所享受的其他税收优惠政策发生变化，将会对公司业绩产生一定影响。

## （3）汇率波动风险

报告期内，公司出口销售收入占主营业务收入比例超过 25%。公司境外销售货款主要以美元结算，汇率的波动给公司业绩带来了一定的不确定性。近年来我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，汇率的波动将影响公司以美元标价外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。

报告期各期，公司汇兑损益金额分别为 611.20 万元、-727.39 万元和-288.60 万元（负数为收益），如未来公司主要结算外币的汇率出现大幅不利变动，或公司对于结汇时点判断错误，将对公司业绩造成一定影响。

## 5、发行失败风险

若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不足法律规定要求，或者发行时总市值未能达到预计市值上市条件的，本次发行应当中止，若发行人中止发行上市审核程序超过交易所规定的时限，或者存在其他影响发行的不利情形，发行人将存在发行失败的风险。

## 6、其他风险

### (1) 募投项目实施风险

公司本次募集资金拟投资项目中的“半导体分立器件产业提升项目”将增加公司产能，存在由于市场需求变化、竞争企业产能扩张等原因而导致的产品销售不畅、产能利用率不足的风险。

截至 2019 年末，公司固定资产账面原值为 50,951.45 万元，本次募集资金投资项目建成后，公司新增固定资产约 25,755.50 万元，增加年折旧费超过 3,000 万元。如果市场环境发生重大不利变化，公司现有业务及募集资金投资项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募集资金投资项目将存在因固定资产折旧大幅增加而影响公司效益的风险。

### (2) 股票价格波动风险

公司股票拟在上交所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，股票价格还将受到投资者心理预期、股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策和各类重大突发事件等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑到前述各类因素所可能带来的投资风险，并作出审慎判断。

### (3) 可能遭受诉讼、索赔而导致的法律风险

公司目前不存在对财务状况、经营成果、公司声誉等产生较大影响的诉讼、仲裁事项。若未来公司因知识产权、产品质量、产品交付延迟或其他违约事项遭受诉讼、索赔，则可能对公司生产经营造成不利影响。

### (4) 本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，由于募集资金投资项目存在一定的建设期，不能在短期内产生经济效益，因此预计公司本次发行后的每股收益、净资产收益率短期内将会有一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

### (5) 对赌协议的风险

2019 年 3 月 9 日，公司股东恒星国际与聚源聚芯签署了股份转让协议，转

让恒星国际所持公司 3% 股份。同日，杨森茂与聚源聚芯签署股份回购协议，就特定情形下回购事宜进行了约定。上述对赌协议相关条款仅限于股东之间，是各方真实、准确的意思表示。虽然相关条款不涉及公司的利益，但是如果未能按时完成约定事项，公司实际控制人杨森茂的回购义务将触发，现有股东持股比例存在可能发生变化的风险。

#### （6）不可抗力风险

若发生自然灾害以及战争、重大疫情等不可抗力事件，可能会对公司的财产、人员、经营造成损害，从而影响公司的经营业绩和盈利能力。2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，并逐渐蔓延至全球。公司严格按照疫情防控政策，推迟复工时间，受此影响，公司一季度经营业绩有所下降。随着疫情逐步得到控制，公司已全面复工，本次疫情未对公司的持续经营产生重大不利影响。但如果本次疫情在海外持续较长时间，可能对全球半导体及下游产业带来较大影响，进而对公司经营情况和盈利水平产生不利影响。

## 二、发行人本次发行情况

（一）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）；

（二）每股面值：人民币 1.00 元；

（三）发行数量：不超过 3,210.00 万股；

（四）发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会、上海证券交易所等监管部门认可的其他发行方式；

（五）发行对象：本次发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所人民币普通股（A 股）证券账户上开通科创板股票交易权限的符合资格的自然人、法人及其他机构（国家法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外），中国证监会或上海证券交易所另有规定的，按照其规定处理。

### 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

#### （一）本次证券发行上市具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定梁宝升、王家海担任本次银河微电首次公开发行股票保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

**梁宝升** 先生，对外经贸大学经济学硕士，保荐代表人，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁。从事投资银行业务 5 年，曾主持或参与的项目有：新泉股份、广大特材 IPO 项目，银河电子、龙元建设非公开发行项目和新泉股份、东音股份可转债等项目。

**王家海** 先生，南京大学管理学硕士，保荐代表人、注册会计师（非执业），现任中信建投证券投资银行部总监，从事投资银行相关业务 9 年，曾主持或参与的项目有：兴业股份、顾家家居、新泉股份、广大特材等 IPO 项目，鱼跃医疗、银河电子、金信诺、龙元建设等非公开项目以及新泉股份可转债项目。

#### （二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为李海龙，其保荐业务执行情况如下：

**李海龙** 先生：准保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部高级经理，先后参与了乐惠国际、迪普科技、锦和商业 IPO 项目及迪马股份公开发行公司债项目。

#### （三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括宣言、刘骁一、王郭。

**宣言** 先生，约翰霍普金斯大学硕士，准保荐代表人，注册金融分析师，现任中信建投证券投资银行部高级经理。从事投资银行业务 4 年，先后参与或负责了徕木股份 IPO 项目以及绿地控股、徕木股份等再融资项目。

**刘骁一** 先生，华东政法大学法学硕士，注册会计师（非执业），现任中信建投证券投资银行部高级经理，先后参与了广大特材、火星人、江苏苏润 IPO 项目及关爱通新三板挂牌项目。

王郭先生，上海交通大学审计硕士，现任中信建投证券投资银行部经理，参与广大特材 IPO 项目、新泉股份可转债项目。

#### 四、保荐机构与发行人关联关系的说明

（一）截至本上市保荐书出具日，除保荐机构将根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律、法规的规定，安排相关子公司参与本次发行战略配售之外，保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）截至本上市保荐书出具日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）截至本上市保荐书出具日，保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）截至本上市保荐书出具日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书出具日，保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。

## 第二节 保荐机构承诺事项

### 一、保荐机构内部审核程序和内核意见

#### （一）保荐机构关于本项目的内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会、上海证券交易所推荐本目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

#### 1、项目的立项审批

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2019 年 12 月 20 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

#### 2、投行委质控部的审核

本保荐机构在投资银行业务委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

本项目的项目负责人于 2020 年 3 月 21 日向投行委质控部提出底稿验收申请；2020 年 3 月 24 日至 2020 年 4 月 7 日，受新冠疫情的影响，投行委质控部对本项目采取了查阅全套电子版工作底稿、视频会议问核等方式进行核查，并对发行人实际控制人、董事长杨森茂及总经理岳廉进行了视频访谈，并于 2020 年 4 月 8 日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

#### 3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核

委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

内核部在收到本项目的内核申请后，于 2020 年 4 月 9 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2020 年 4 月 16 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。

参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上海证券交易所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会、上海证券交易所正式推荐本项目。

## **(二) 保荐机构关于本项目的内核意见**

本次发行申请已按照法律法规和中国证监会及上海交易所的相关规定，保荐机构对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。并具备相应的保荐工作底稿支持。

## **二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺**

(一) 有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

(二) 有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(三) 有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

(四) 有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。



## 第三节 对本次发行的推荐意见

### 一、发行人就本次发行上市履行了必要的决策程序

2020年3月17日，发行人召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

2020年4月2日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经本保荐机构核查，发行人第二届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会的召集、召开方式、与会人员资格、表决方式及决议内容，符合《证券法》、《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序，决策程序合法有效。

### 二、发行人符合科创板定位

本保荐机构已按照《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》以及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（以下简称“暂行规定”）的相关规定对发行人是否符合科创板定位要求进行了审慎核查，具体情况如下：

保荐机构查阅了发行人主营业务收入构成情况，对发行人归属行业进行了分析；核查了发行人相关政府补助文件和所得税税收优惠文件；对报告期内主要客户、供应商进行了实地和视频访谈，了解发行人与主要客户、供应商的业务的合作情况，了解上下游企业对发行人的评价；查阅了发行人与主要客户的销售合同或订单，及主要供应商的采购合同；查阅了与发行人业务有关的可比上市公司招股说明书、年度报告、财务数据等资料，与发行人进行对比分析；对发行人所处行业搜集了深度研究报告和市场数据；查阅了报告期内的发行人会计师出具的

《审计报告》；查阅了发行人获得的《高新技术企业证书》、《中国半导体功率器件十强企业》等荣誉资质证书；对发行人进行实地查看并对实际控制人、高级管理人员、核心技术人员进行了访谈，了解发行人的商业模式、核心技术和创新机制；取得了发行人报告期内研发费用明细表，通过对研发费用执行实质性审计程序进行确认；查阅了公司获得的相关专利等文件；查阅了国家出台的相关战略文件。

经核查，本保荐机构认为，发行人所从事的业务及所处行业符合国家战略，属于面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的科技创新行业。同时，发行人具备关键核心技术并主要依靠核心技术开展生产经营，具有较强的科技创新能力，商业模式稳定，市场认可度较高，社会形象良好，成长性较强，符合相关法律法规对科创板定位的要求。

### 三、发行人符合《科创属性评价指引（试行）》及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》规定的发行条件

#### （一）发行人符合科创板行业领域的规定

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	公司主要从事半导体分立器件的研发、生产和销售，属于新一代信息技术领域的半导体行业。
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

#### （二）发行人符合科创属性要求的规定

发行人最近3年累计研发投入占最近3年累计营业收入比例5%以上，且最近3年研发投入金额累计在6000万元以上，发行人形成主营业务收入的发明专利大于5项，最近一年营业收入大于3亿元，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条规定。具体如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为5.90%；最近三年累计研发投入10,174.80万元。
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司目前取得发明专利23项，

≥5 项		其中形成主营业务收入的发明专利超过 5 项。
最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3 亿	■是 □否	公司最近一年营业收入 5.28 亿元。

#### 四、发行人符合上市条件

##### （一）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

中信建投证券对发行人首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，结果如下：

##### 1、发行人的设立时间及组织机构运行情况

本保荐机构查阅了发行人的工商档案、有关主管部门出具的证明文件等资料。经核查，确认发行人成立于 2006 年 10 月 8 日，于 2016 年 11 月 18 日整体变更为股份有限公司，自成立以来持续经营并合法存续，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的有关规定。

##### 2、发行人财务规范情况

本保荐机构查阅了发行人财务报告、申报会计师出具的《审计报告》等相关财务资料，并取得了财务相关的内外部文件。经核查，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

##### 3、发行人内部控制情况

本保荐机构查阅了发行人会计师出具的《内部控制鉴证报告》等内控资料，并与发行人相关人员进行了访谈。经核查，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

#### 4、发行人资产完整性及人员、财务、机构独立情况

本保荐机构查阅了发行人的业务合同、三会文件、申报会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

#### 5、业务、控制权及主要人员的稳定性

本保荐机构查阅了发行人三会文件、申报会计师出具的《审计报告》等资料。经核查，发行人的主营业务为半导体分立器件的研发、生产和销售，通过核心技术高质量的科技成果转化，为下游应用领域提供小信号器件、功率器件、光电器件等产品。发行人最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员整体稳定，均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近2年实际控制人没有发生变更，均为杨森茂，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。

#### 6、资产权属情况

本保荐机构查阅了发行人重要资产的权属证书、银行征信报告、申报会计师出具的《审计报告》等资料，并查询了裁判文书网。经核查，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，亦不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。

#### 7、发行人经营合法合规性

本保荐机构查阅了发行人相关业务合同、申报会计师出具的《审计报告》，并与发行人相关人员进行了访谈，发行人主营业务为半导体分立器件的研发、设计、生产和销售，通过核心技术高质量的科技成果转化，为下游应用领域提供小信号器件、功率器件、光电器件等产品。根据发行人的陈述并经查验发行人持有

的营业执照、公司章程、有关产业政策，发行人的生产经营符合法律、行政法规，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

#### **8、发行人、控股股东及实际控制人的守法情况**

本保荐机构对发行人相关人员进行了访谈，取得了发行人控股股东、实际控制人的承诺，并查询了国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网等网站，同时取得了市场监督管理局、税务局等政府机关出具的发行人及控股股东不存在违法违规行为的证明文件。经核查，最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

#### **9、董事、监事和高级管理人员的守法情况**

本保荐机构对发行人相关人员进行了访谈，并取得了发行人董事、监事和高级管理人员分别出具的声明，以及公安局出具的《无犯罪记录证明书》，并在中国证监会网站的证券期货市场失信记录查询平台进行查询。经核查，发行人的董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款的规定。

#### **(二) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定**

本次发行前，发行人股本总额为 9,630.00 万股，若本次公开发行的 3,210.00 万股股份全部发行完毕，公司股本总数将达到 12,840.00 万股，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

#### **(三) 符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定**

根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议，发行人本次拟公开发行股票

数量不超过 3,210.00 万股，占发行后总股本比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条的规定。

#### **（四）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定**

根据申报会计师出具的《审计报告》，发行人 2018 年度、2019 年度归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 5,315.85 万元与 4,961.14 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。

参照发行人 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润和同行业可比公司平均市盈率，公司预计市值不低于 10 亿元。

发行人符合《上市规则》第 2.1.2 条第一款第（一）项的上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

#### **（五）符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（五）上海证券交易所规定的其他上市条件”规定**

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

### **五、对发行人持续督导工作的安排**

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。

#### **（一）持续督导期限**

发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导期间为股票上市当年剩余时间以及其后 3 个完整会计年度。持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作由本保荐机构继续完成。

## (二) 持续督导事项和持续督导计划

事 项	安 排
(一) 持续督导事项	
督促上市公司建立和执行信息披露、规范运作、承诺履行、分红回报等制度	<p>1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；</p> <p>2、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向交易所报告。</p>
识别并督促上市公司披露对公司持续经营能力、核心竞争力或者控制权稳定有重大不利影响的风险或者负面事项，并发表意见	<p>1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，持续跟进上市公司经营情况和其他影响持续经营能力、核心竞争力的情况并及时向交易所报告；</p> <p>2、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向交易所报告。</p>
关注上市公司股票交易异常波动情况，督促上市公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定履行核查、信息披露等义务	<p>1、持续关注公司上市后的股票交易情况，对于交易异常的情况及时与公司进行沟通并报交易所披露；</p> <p>2、督导发行人遵守首次公开发行股票并在科创板上市所做的关于稳定股价的各项承诺。</p>
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	<p>1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；</p> <p>2、参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；</p> <p>3、建立重大财务活动的通报制度；</p> <p>4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向交易所报告，并发表声明。</p>
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	<p>1、督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订完善的分权管理和授权经营制度；</p> <p>2、督导发行人建立对高管人员的监管机制，完善高管人员的薪酬体系；</p> <p>3、对高管人员的故意违法违规的行为，及时报告证券交易所，并发表声明。</p>
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	<p>1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定；</p> <p>2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定；</p> <p>3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项；</p> <p>4、督导发行人采取减少关联交易的措施。</p>
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等	<p>1、督导发行人严格按照招股说明书中承诺的投资计划使用募集资金；</p>

事 项	安 排
承诺事项	2、要求发行人定期通报募集资金使用情况； 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告； 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督导发行人及时公告。
持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序； 2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项； 3、对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券交易所报告，并发表声明。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息； 2、根据有关规定，对发行人违法违规事项发表公开声明。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定； 2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。
(四) 其他安排	在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

## 六、保荐机构结论性意见

中信建投证券接受发行人委托，担任其本次首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，根据《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了审慎调查。

本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价，对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市履行了内部审核程序并出具了内核意见。

本保荐机构内核部门及保荐代表人经过审慎核查，认为发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市符合根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科



创业板股票发行上市审核规则》等规定，同意保荐发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 李海龙

李海龙

保荐代表人签名: 梁宝升

梁宝升

王家海

王家海

内核负责人签名: 林煊

林煊

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

保荐机构法定代表人签名: 王常青

王常青

